



## Deep Access Wedge-Wedge Bonder 5632

### Bond System

<b>Drahttypen</b>	Alu- und Golddrähte 17,5-75µm auf 2"-Spule Bändchen von 30x12,5µm bis 250x25µm
<b>Bondkopf</b>	Deep Access Wedge für Dünndraht oder Bändchen Standard Tool von 1" Länge (optional ¾") Motorisierte Drahtabspulung (optional)
<b>Ultraschall System</b>	F&S Generator 67kHz (optional 40, 90, 120kHz)

### Maschinen Basis

<b>Achsen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeitsbereich X/Y-Achse 100x100mm Z-Achse 60mm</li> <li>Schrittauflösung 0,25µm</li> <li>Wiederholgenauigkeit &lt;2µm</li> </ul>
<b>Hardware</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dual Core PC, 1,6 GHz Prozessor,</li> <li>4 GB RAM, Ethernet, 4x USB-Hub Front</li> <li>Firewire CCD Farbkamera 1,4 MPixel</li> <li>Netzwerkfähig mit TCP/IP Server zur</li> </ul>
<b>Software</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einzelbonds bis komplexe Programme,</li> <li>Loopformen in Bibliotheken speicherbar</li> <li>Optionale Bilderkennung</li> </ul>
<b>Geschwindigkeit</b>	20 Drähte ≤ Minute
<b>Abmessung</b>	B x T x H – 70 x 65 x 70 cm, Gewicht ca. 80kg
<b>Anschlüsse</b>	100-240 VAC, 1 Phase, 50/60 Hz, max 500 VA Ø 6mm Standard-Vakuumschlauch
<b>Heizung</b>	Steuerung in der Maschine integriert 0-250 °C

### Die 56xx Serie:

Der semiautomatische Deep-Access Wedge Bonder 5632 ist auf Basis der 56xx-Serie voll PC-gesteuert und es sind beliebig viele Bonds oder Bumps programmierbar.

Die programmierten Zielpunkte werden über das Kamerazielfadenkreuz angefahren und die programmierten Bonds oder Bumps werden automatisch gebondet.

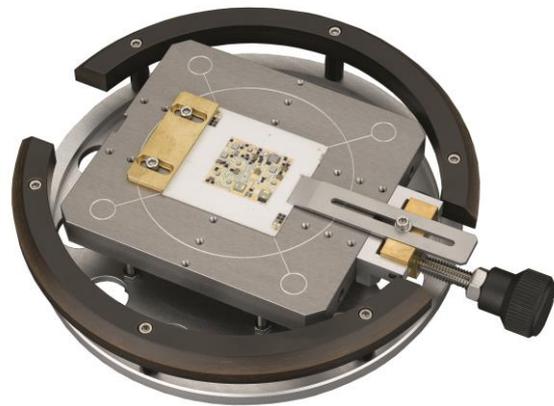
F&S Bondtec bietet bei dieser Maschine zwei Modis an: Singlebond zum Reparieren von div. Bond-samples und zum Setzen von Einzelbonds (manuell -automatisch) und Multiwire zum Teachen und Bonden von Chips oder div. Bondsamples (semi- und vollautomatisch).

Durch einfachen Wechsel der Bondkopfe und der Software kann diese Maschine auch auf Dünndraht, Dickdraht Wedge-Wedge oder Heavy Ribbon Bonder umgerüstet werden. Ebenso ist die Maschine als Pull-/Sheartester einsetzbar.

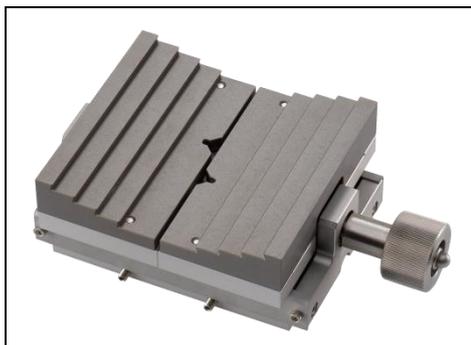
Werkzeugloses Umrusten in ca. 5 Minuten möglich.

## Substrathalter

Standard-Substrataufnahme  
für Bauteile bis 4x4" mit  
Vakuum und mechanischer Klemmung



## Optional:



Substrathalter 4x4"  
mit Stufenbacken



TO Aufnahme mit  
mechanischer Klemmung



4x4" Substrataufnahme m.  
gummierter Oberfläche, mit  
mechanische Klemmung

### F&S Bondtec Semiconductor GmbH

Industriezeile 49a

A-5280 Braunau am Inn

Tel.: +43-7722-67052-8270

Fax: +43-7722-67052-8272

Mail: [info@fsbondtec.at](mailto:info@fsbondtec.at)

Web: [www.fsbondtec.at](http://www.fsbondtec.at)

**Hilpert**  
electronics

Ihr Vertriebspartner/ Votre représentant:

Hilpert electronics AG  
Täferenstrasse 29  
5405 Baden-Dättwil  
Schweiz / Suisse

Tel: +41 56 483 25 25  
Fax: +41 56 483 25 20  
Mail: [office@hilpert.ch](mailto:office@hilpert.ch)  
Web: [www.hilpert.ch](http://www.hilpert.ch)

